

フレキシブル基板対応 無電解ニッケル/金めっきプロセス

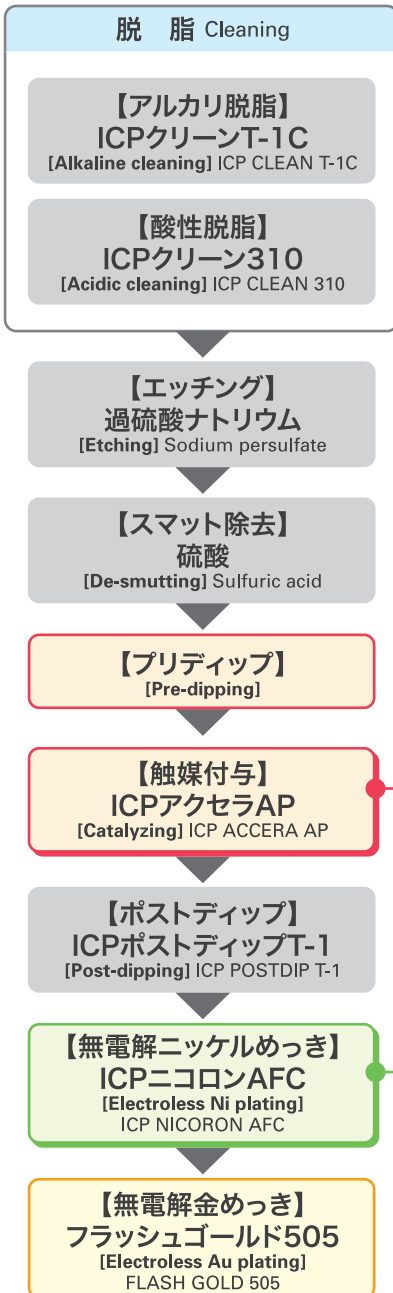
トップ ICP FEEL プロセス

Electroless Ni/Au Plating Process Applicable to FPC Boards

TOP ICP FEEL PROCESS

- ▶ 低金属濃度化によるコスト削減、環境負荷低減
 - ▶ 耐折性が良好で、フレキシブル基板に最適
 - ▶ ファインパターン性に優れ、微細配線へのめっきにも対応
- Reduce cost and environmental load by decreasing metal concentration
 - Excellent in folding endurance, best for FPC boards
 - Excellent in fine patterning performance, applicable to ultra-micro patterning

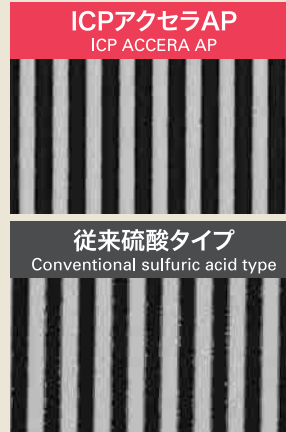
処理工程 Process



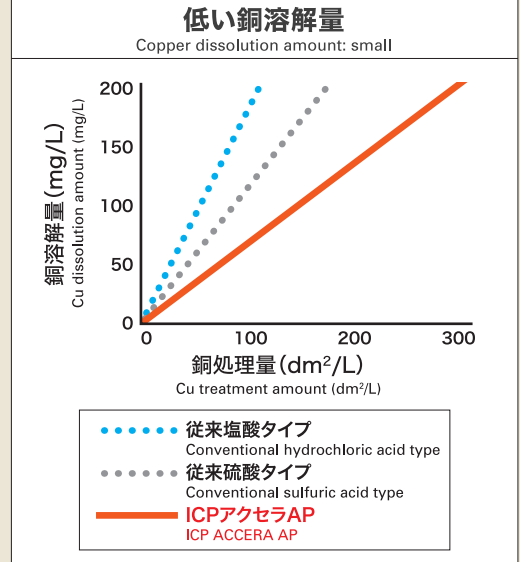
ICPアクセラAP ICP ACCERA AP

- ◎パラジウムの低濃度化 (Pd:20mg/L)
- ◎銅溶解量が低く、長期使用が可能
- Low palladium concentration (Pd:20mg/L)
- Copper dissolution amount is small, long bath life is possible

優れたファインパターン性
Excellent fine pattern ability



※L/S=15/25
無電解ニッケルめっき:3μm
Electroless nickel plating:3μm



ICPニコロンAFC ICP NICORON AFC

- ◎ニッケルの低濃度化 (Ni:3.0g/L)
- ◎耐折性に優れた皮膜が得られる
- Low nickel concentration (Ni:3.0g/L)
- High folding endurance come available

